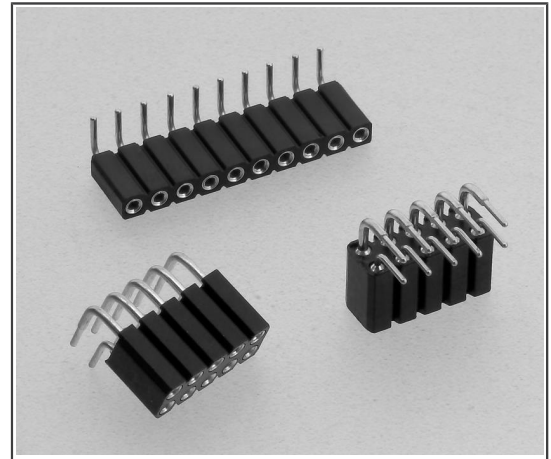


# Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig

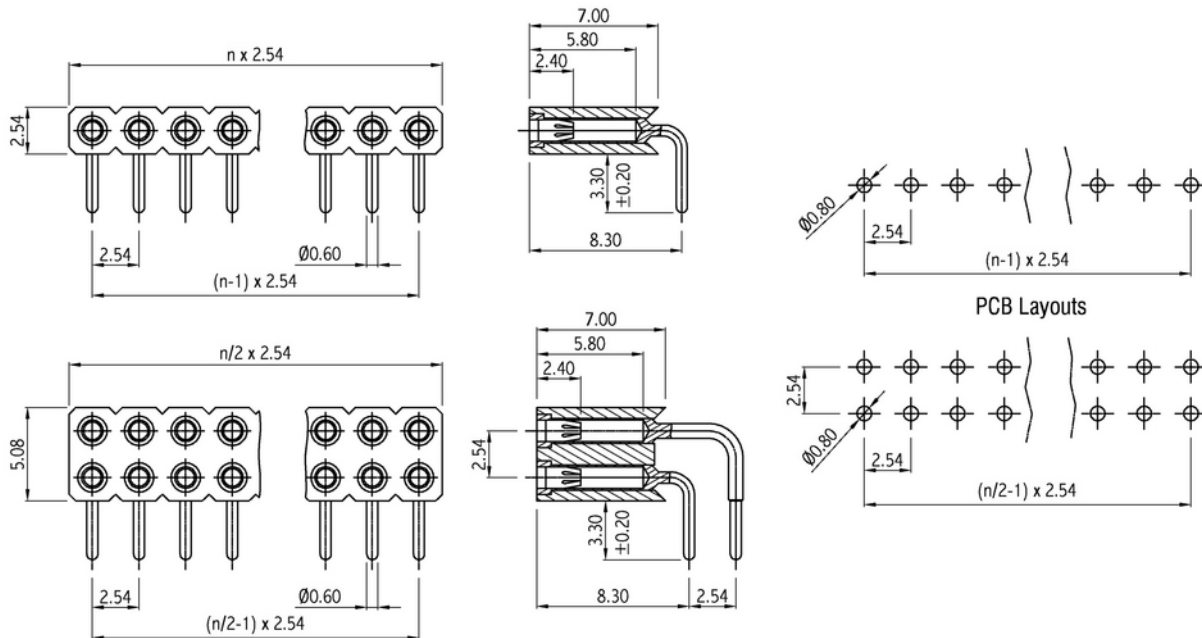
## Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row

**Technische Daten / Technical Data**

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
<i>Contact Material</i>	Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
	<i>Sleeve: screw machined brass</i>
	<i>Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>&lt; 10 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
<i>Test Voltage</i>	<i>1 kV RMS</i>
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
<i>Voltage Rating</i>	<i>100 V RMS / 150 V DC</i>
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	<i>3 A</i>
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-55 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>



Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.  
 Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins.  
 Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Rows*</b>	<b>Sleeve Plating</b>	<b>Clip Plating*</b>
TC-0308	002	1	50	00
	002-050 Einreihig <i>Single row</i> 004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i> 2 Zweireihig <i>Double row</i>	50 Hülse verzinkt <i>Tin plated sleeve</i>	00 Feder vergoldet <i>Gold plated clip</i> 10 Feder 0,25µm Gold (Option) <i>0.25µm gold plated clip (Option)</i> 30 Feder 0,75µm Gold <i>0.75µm gold plated clip</i> 50 Feder verzinkt <i>Tin plated clip</i>

Für die einreihige Variante gilt eine Verarbeitungsgarantie bis 25-polig.  
 For single row headers, we guarantee processing for up to 25 contacts.

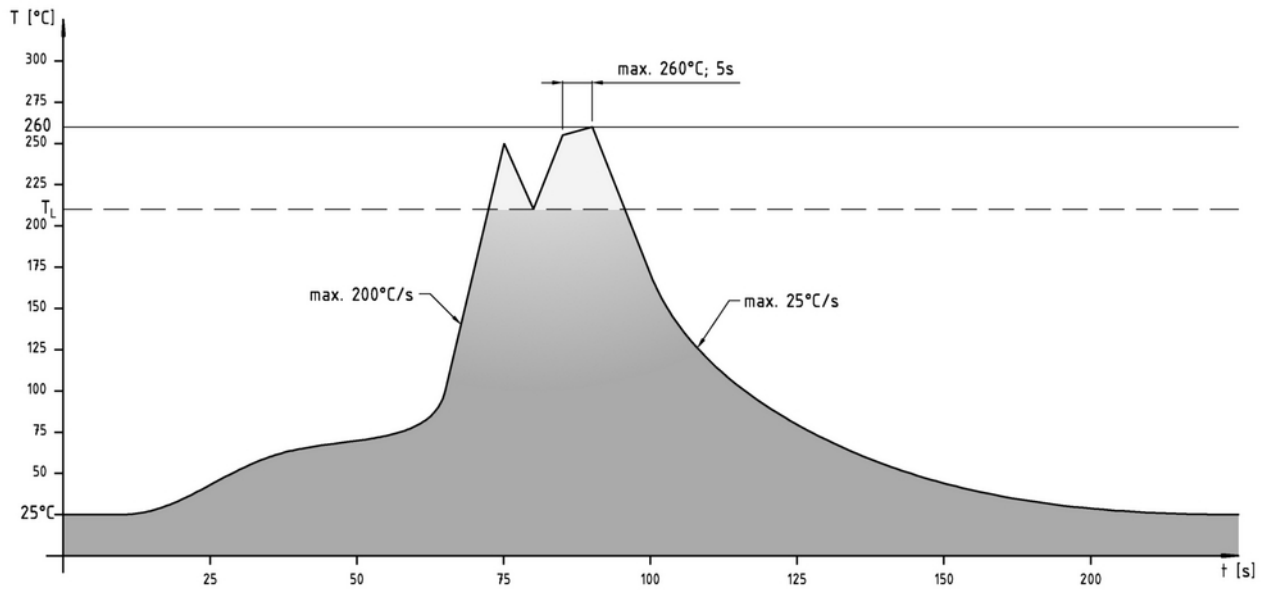
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

